



## ENDE2019 COMMITTEE

### General Chair

**GuiYun Tian**

University of Electronic Science and Technology of China /Newcastle University

### Co-Chairs

**Zhenmao Chen**, Xi'an Jiaotong University

**Junming Lin**, Eddysun Electronic Corp.

**Tianpeng Qiang**, Special Equipment Safety Supervision Inspection Institute of Jiangsu Province

**Xiaorong Gao**, Southwest Jiaotong University

### Exhibits and Publicity Chair

**Tianpeng Qiang**, JSSEI

### Publications Chair

**GuiYun Tian**, UESTC

**Zhenmao Chen**, XJTU

### Awards Co-Chairs

**Xiaorong Gao**, SWJU

**Helena Geirinhas Ramos**, IT/IST, Universidade de Lisboa, Portugal

**Marco Ricci**, University of Calabria, Italy

### Webmaster

**Liangyin Chen**, SCU

### General Management

**Jianpeng Peng**, SWJU

### Secretariat

**Bo Tian, Bin Gao**

Qingshuihe Campus, UESTC, No. 2006, Xiyuan Ave West Hi-Tech Zone, 611731, Chengdu, Sichuan, P. R. China

Tel: +86-18980697050,

+86-13880704507

E-mail:ende2019@sina.com

## Call for Papers- (ENDE2019)

<http://www.ende2019.com>

### THE 24th INTERNATIONAL WORKSHOP ON ELECTROMAGNETIC NONDESTRUCTIVE EVALUATION

September 11-14, Chengdu, Sichuan, P.R. China

Welcome to ENDE2019! The International Workshop on Electromagnetic Non-Destructive Evaluation (ENDE) was first held in England in 1995 and has subsequently been held in Japan, Italy, France, America, Hungary, Germany, South Korea, Poland, Portugal, India, Brazil, and Slovakia. In 2014, the 19th workshop was held in Xi'an, China. In 2019, it will come back to China again and will take place in Chengdu on September 11-14. As usual, the 24th workshop will focus on the theoretical, experimental and applied research on Electromagnetic Non-Destructive Evaluation methods. It will provide a wonderful opportunity to exchange ideas and update on the latest developments.

#### Topics of interest include but are not limited to:

Advanced ENDE sensors

Analytical and numerical modeling of ENDE

Integrated ENDE systems

Inversion problem, reconstruction and quantification

Imaging, signal and image processing

QNDE and AI for ENDE

Material characterization (damages and micro-defects)

Monitoring and diagnosis of mechanical structures

New developments in ENDE

Innovative industrial applications of ENDE

#### Workshop Publications

Authors are invited to submit short papers of up to two pages relevant to the workshop topics. Papers should be presented with an original work not submitted or published elsewhere. Short papers are to be reviewed by our Scientific Committee. The accepted papers will be included in the workshop proceedings. Authors of accepted short papers are encouraged to submit full papers (4-6 pages long), which will be peer reviewed for inclusion in a volume of the ISTP indexed book series "Studies on Applied Electromagnetic and Mechanics".

#### Important Dates

Apr. 30, 2019

Deadline for submission of short paper

May. 20, 2019

Notification of acceptance

Jul. 31, 2019

Deadline of early bird registration

Sep. 11-14, 2019

Workshop

Nov. 1, 2019

Deadline for full paper submission

#### Social Activities

(1) Welcome Party on the evening of September 11<sup>th</sup>

(2) Conference Dinner on the evening of September 13<sup>th</sup>

Details are posted on the conference website <http://www.ende2019.com>

#### Presentation and Working Language

English is the official language of the workshop and will be used for all printed materials, presentations and discussions. The symposium will include both oral and poster sessions.





## ENDE2019 学术报告/论文征集通知

<http://www.ende2019.com>

### 第二十四届电磁无损评估国际研讨会

### THE 24th INTERNATIONAL WORKSHOP ON ELECTROMAGNETIC NONDESTRUCTIVE EVALUATION

2019年9月11-14日, 中国四川省成都市

诚挚地邀请您参加第24届国际电磁无损评估研讨会(ENDE2019)! 国际电磁无损评估研讨会(ENDE)于1995年首次在英国举办, 随后分别在日本, 意大利, 法国, 美国, 匈牙利, 德国, 韩国, 波兰, 葡萄牙, 印度, 巴西和斯洛伐克等国举办。2014年, 中国西安举办了第19届研讨会。2019年, 它将再次回到中国, 来到成都。第24届研讨会的重点议题涉及电磁无损评估方法的理论、实验和应用创新性研究。它将为国内外电磁无损评估及检测领域的专家学者、研究人员、技术人员提供一个进行思想、学术与技术交流的平台和获取最新研究成果的绝佳机会。

诚邀来自全世界的参会代表踊跃论文投稿, 稿件主题涉及但不限于以下:

先进的 ENDE 传感器  
ENDE 的分析和数值模拟  
ENDT&E 集成/融合系统  
反演问题、重构与量化  
成像、信号和图像处理  
ENDE 量化无损评估和人工智能  
材料表征  
机械结构的监测和诊断  
ENDE 新发展  
ENDE 工业创新应用

#### 研讨会出版物

参会作者提交不超过两页的与研讨会主题相关的简短论文。提交的论文需是未在其它地方提交或发布的原创作品。论文评审委员会将对提交的简短论文进行评审。被接收的论文将纳入研讨会会议论文集。鼓励已接收的短文的作者提交完整的论文(长4-6页), 完整论文将提交同行评审, 通过评审的完整论文将纳入 IISTP 索引, 由 IOS Press 系列丛书“应用电磁与力学研究”出版。

#### 重要日期

短论文提交截止日期	2019年4月30日
短论文接收通知	2019年5月20日
早鸟注册截止日期	2019年7月31日
会议日期	2019年9月11~14日
全文提交截止日期	2019年11月30日

#### 社交活动

- (1) 欢迎酒会 ~9月11日晚间
- (2) 会议晚宴 ~9月13日晚间

相关细节请访问会议网站 <http://www.ende2019.com>

#### 演讲和工作语言

英语是研讨会的官方语言, 将用于所有印刷材料, 演示和讨论。专题讨论会由口头报告和海报展示共同组成。

#### ENDE2019 委员会

##### 大会主席

田贵云  
电子科技大学 / 纽卡斯尔大学

##### 联合主席

陈振茂, 西安交通大学  
林俊明, 爱德森院士专家工作站  
强天鹏, 江苏省特种设备安全监督  
检验研究院  
高晓蓉, 西南交通大学

##### 展览和宣传主席

强天鹏, 江苏省特种设备安全监督  
检验研究院

##### 出版主席

田贵云, 电子科技大学  
陈振茂, 西安交通大学

##### 奖励委员会联合主席

高晓蓉, 西南交通大学  
Helena Geirinhas Ramos, IT/IST,  
里斯本大学 [葡萄牙]  
Marco Ricci, 卡拉布里亚大学 [意  
大利]  
Christophe Reboud, CEA LIST, [法  
国]

##### 网站管理

陈良银, 四川大学

##### 综合管理

彭建平, 西南交通大学

##### 大会秘书

田波, 高斌  
电子科技大学清水河校区,  
四川省成都市高新西区西源大道  
2006号  
联系电话: 18980697050  
13880704507  
E-mail: ende2019@sina.com

